天津经济技术开发区生态环境局关于伯芯微电子（天津）有限公司集成电路先进封装项目

环境影响报告表的批复

伯芯微电子（天津）有限公司：

你公司所报《伯芯微电子（天津）有限公司集成电路先进封装项目环境影响报告表》收悉，经审核后批复如下：

一、根据该项目完成的环境影响报告表结论及评估报告，同意在开发区微电子工业园微七路2号进行“集成电路先进封装项目”建设。该项目拟租赁中晓园厂房1-AB栋建设3条DFN和QFN封装生产线，主要包括固晶切割、固晶、固化、焊线、塑封、框架划片、烘干、测试、分选、打码、编带等工序，预计年产封装芯片12亿只（其中DFN封装芯片产品数为10亿只，QFN封装芯片产品数为2亿只）。该项目总投资5000万元，环保投资29万元，占投资总额的0.58%。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，你公司已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的说明报告。该项目环评报告表全本信息在我局政务网上进行了公示。

三、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施，其中应重点落实以下内容：

（一）该项目晶圆固化废气、塑封废气经收集进入一套活性炭吸附装置处理，由1根15米高排气筒（P1）达标排放。

上述废气中，TRVOC、非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应标准限值，甲苯、酚类、环氧氯丙烷、苯乙烯（排放浓度）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）相应标准限值，苯乙烯（排放速率）、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应标准限值。

该项目无组织排放源为芯片生产过程激光打码废气、编带密封废气，经洁净车间测试区循环风系统加装的活性炭过滤装置净化后无组织排放。厂房界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相应标准限值；厂界非甲烷总烃执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准限值。

你公司在实际建设和运行过程中，应合理布置废气收集装置并做好废气处理设施的运行维护，及时更换活性炭等，确保废气有效收集、处理及达标排放，严格控制无组织排放。

（二）该项目外排废水为切割冷却循环水排水、纯水制备排浓水和生活废水，经化粪池后通过废水总排口达标排入市政污水管网。废水总排口五日生化需氧量执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准，其余污染物执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）相应标准限值。

（三）该项目厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。

（四）该项目投产后产生的一般固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，做好收集、转运、处置及利用；危险废物应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，妥善收集、储存，并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。

（五）该项目应按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）、《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测〔2007〕57号）要求，落实排污口规范化有关规定，重点关注废气采样口和采样监测平台、爬梯的规范化设置。

四、该项目建成后，新增大气主要污染物排放总量为：VOCs 0.0017吨/年，新增水主要污染物排放总量为：化学需氧量0.5311吨/年、氨氮0.0426吨/年。

五、你公司应按照相关部门要求及时对污染防治设施开展安全风险辨识和评估，将其安全管理措施一并纳入全厂安全生产规章制度中，自觉接受相关部门监管。

六、你公司应按照相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求及时申请、延续、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等有关规定，你公司应在该项目投入生产或使用前完成“环境应急预案”编制（修订）及备案工作。

八、根据《建设项目环境保护管理条例》，你公司应在投入生产或使用前对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行；同时应当依法向社会公开验收报告。

九、该项目报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自报告表批复文件批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告表应当报我局重新审核。

特此批复。

天津经济技术开发区生态环境局

2025年9月9日

（此件主动公开）